

金冠电气股份有限公司 投资者关系活动记录汇总表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）
时间	2024年5月13日
地点	上海证券交易所上证路演中心
公司接待人员姓名	董事长兼总经理：樊崇 副总经理兼财务总监、董事会秘书：贾娜 独立董事：吴希慧
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司进军新能源板块，目前各个研发项目进展如何？市场开拓情况如何？</p> <p>尊敬的投资者您好！公司在新能源业务方面不断加大研发投入，并持续取得进展。截止2023年12月31日，公司在研项目30项，其中新能源板块相关在研项目13项，相关研发项目进展详见公司于2024年4月24日披露的《金冠电气股份有限公司2023年年度报告》。</p> <p>公司充电桩产品功率覆盖范围7kW-600kW，可实现300V-1000V超宽范围恒功率输出，小直流充电桩、全液冷充电堆、智能有序充电等新产品陆续投入市场。</p> <p>公司深耕县域充电桩市场，在保持整县推进市场业务的同时，拓展县域平台公司业务市场和To C市场，充电桩产品已在27个县市实现销售业绩；电化学储能设备与系统业务应用于社旗县、桐柏县、方城县、淇县等地区的光储充一体化示范项目和漯河市召陵区分布式储能设备采购项目。感谢您的关注！</p> <p>2、请问公司正在研发的IGBT基板到了那个程度？有交付下游客户验证没？谢谢</p> <p>尊敬的投资者您好！公司聚焦IGBT等大功率半导体封装用的高端氮化铝和氮化硅陶瓷基板、直接键合铜DBC和活性金属钎焊AMB覆铜基板产品研发，已完成常规氮化铝和氮化硅陶瓷基板以及直接键合铜DBC覆铜基板和活性金属钎焊AMB覆铜基板的研发。目前，公司正致力于蚀</p>

	<p>刻、化学镀、激光切割等后道工艺的研究。公司将继续加大研发投入，研发高导热氮化铝陶瓷基板、硅粉氮化工艺制备氮化硅陶瓷基板等产品，进一步提升产品的性能和竞争力。具体研发进展请关注公司在指定信息披露媒体披露的定期报告和临时公告。感谢您的关注！</p> <p>3、董秘你好，能否介绍一下贵公司的5C快充设备？</p> <p>尊敬的投资者您好！公司已完成全液冷大功率充电桩样机的调试工作，下一步进行工程样机的开发。公司根据行业技术发展动向和客户需求，对液冷充电桩、智能有序充电、高压快充等技术进行研发。感谢您的关注！</p>
附件清单	无